

**TAZMO**

# タツモ株式会社 決算説明資料

2026年12月期 第一四半期

2026年5月15日

証券コード 6266

会社案内ダウンロード



<https://tazmo.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/company%20guide.pdf>

# INDEX

## 目次



1. 2026年12月期第1四半期 連結業績
2. セグメント別業績
3. 市場（顧客）の状況
4. 補足資料



**1**

# 2026年12月期第1四半期 連結業績

売上高

5,967百万円

前年比  $\Delta$ 20.6%

営業利益

86百万円

前年比  $\Delta$ 92.9%

経常利益

186百万円

前年比  $\Delta$ 84.1%

親会社株主に帰属  
する四半期純利益

111百万円

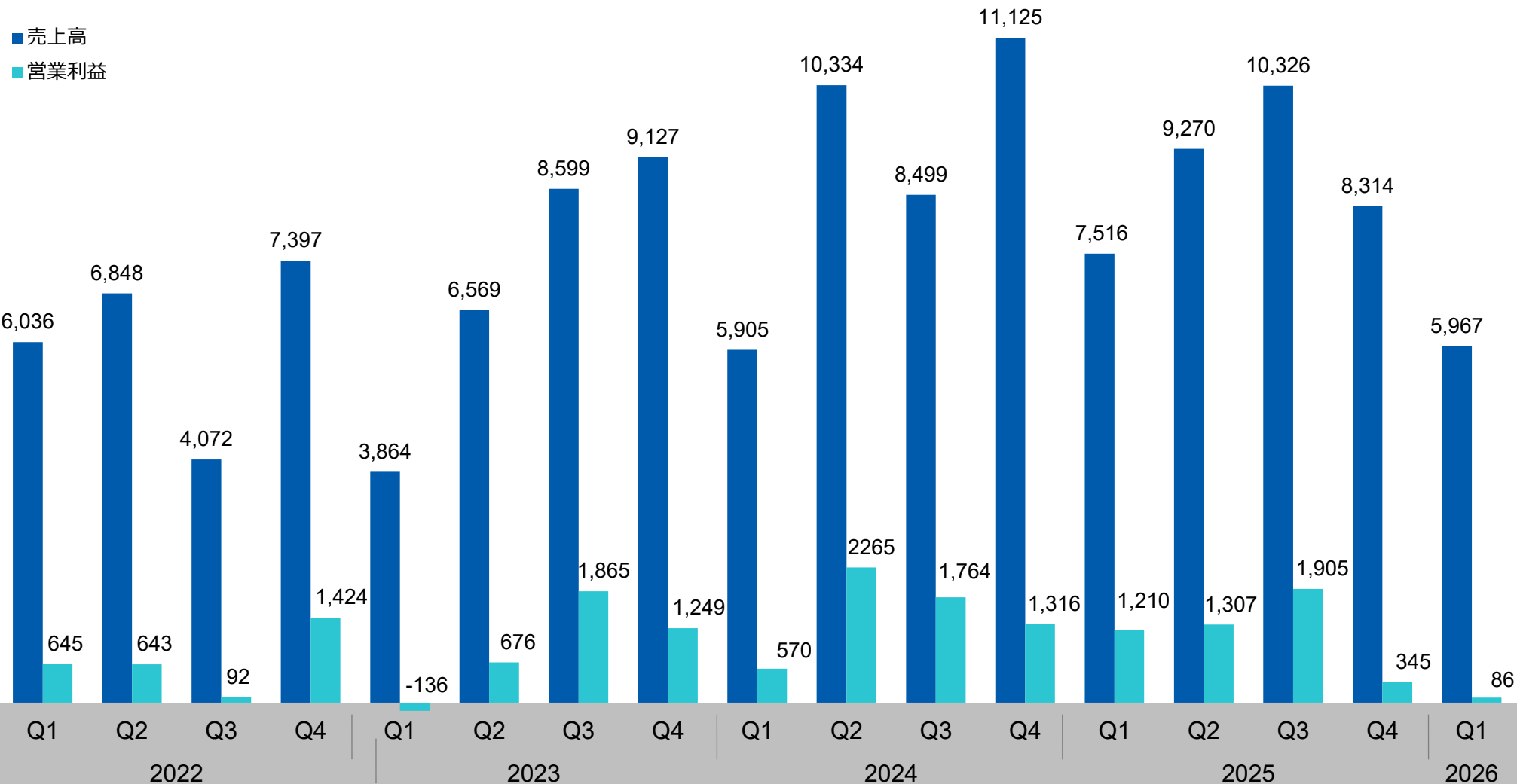
前年比  $\Delta$ 87.0%

■ 概況

- 前期比で減収減益。半導体装置、搬送機器、表面処理用機器事業で、売上は計画が未達となったが、利益は概ね計画通りの結果となった。
- 半導体製造装置と搬送機器で、受注高を大きく伸ばすことができた。市場の改善に伴い、全体的には回復傾向にあるが、事業間で受注量やそのタイミングに大きなばらつきが出ている。

(百万円)	2025年12月期 Q1 実績	2026年12月期 Q1		前期比 増減率(%)	2026年12月期 計画	進捗率(%)
		実績	売上比(%)			
売上高	7,516	5,967	—	△20.6	35,500	16.8
売上総利益	2,606	1,624	27.2	△37.7	—	—
営業利益	1,210	86	1.4	△92.9	3,600	2.4
経常利益	1,176	186	3.1	△84.1	3,500	5.3
親会社株主に帰属する 四半期純利益	855	111	1.9	△87.0	2,500	4.5

# 連結売上高／連結営業利益推移



(百万円)	2025年12月期	2026年12月期Q1	前期比増減
流動資産	37,809	36,605	△1,204
固定資産	9,083	9,456	373
有形固定資産	7,812	8,178	366
無形固定資産	199	196	△3
投資その他資産	1,070	1,081	10
<b>総資産合計</b>	<b>46,893</b>	<b>46,062</b>	<b>△830</b>
流動負債	14,393	12,964	△1,428
固定負債	5,462	6,337	874
<b>負債合計</b>	<b>19,855</b>	<b>19,302</b>	<b>△553</b>
<b>純資産合計</b>	<b>27,037</b>	<b>26,760</b>	<b>△277</b>
自己資本比率	56.6%	57.0%	0.4P

## 主な増減要因

### 流動資産

現金及び預金	△808
受取手形及び売掛金	+145
電子記録債権	△195
棚卸資産	△260

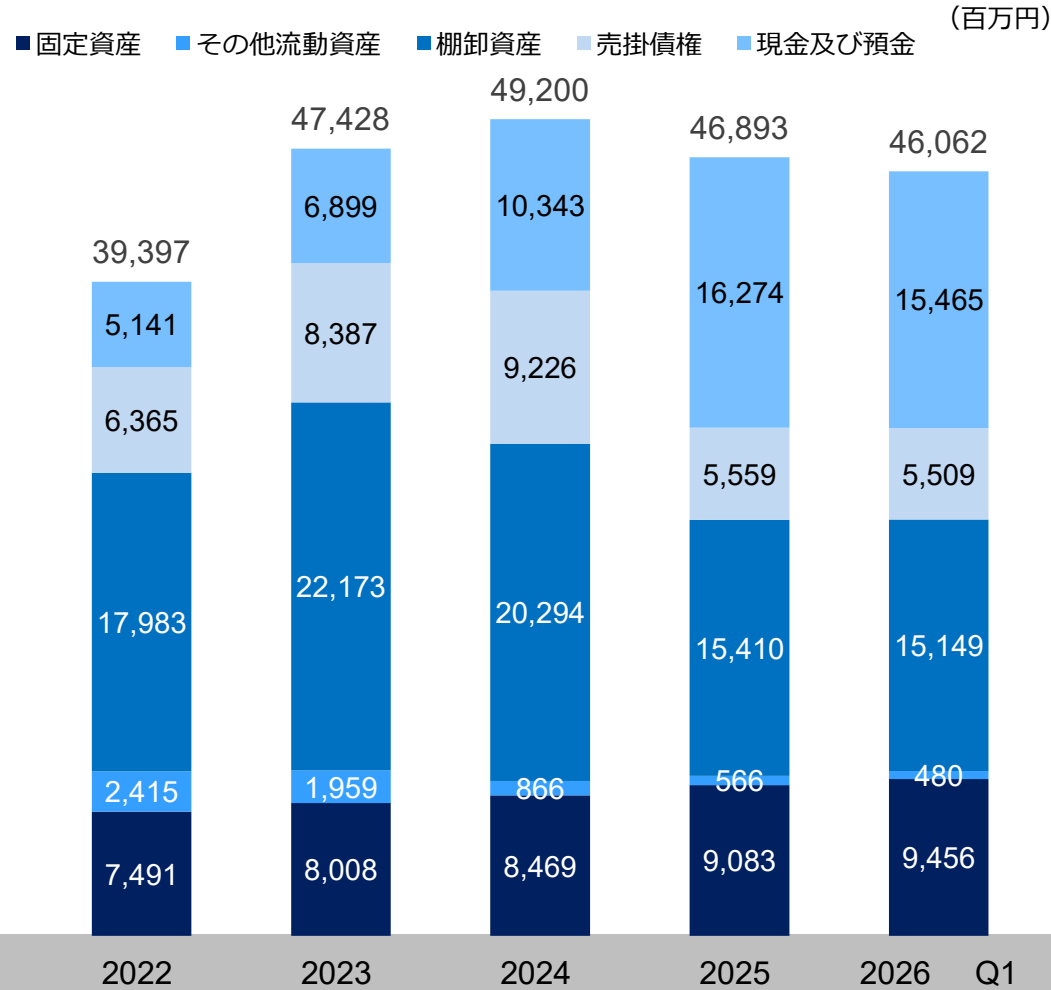
### 流動負債

電子記録債務	△1,728
未払金	△570
未払法人税等	△700
契約負債	+1,122

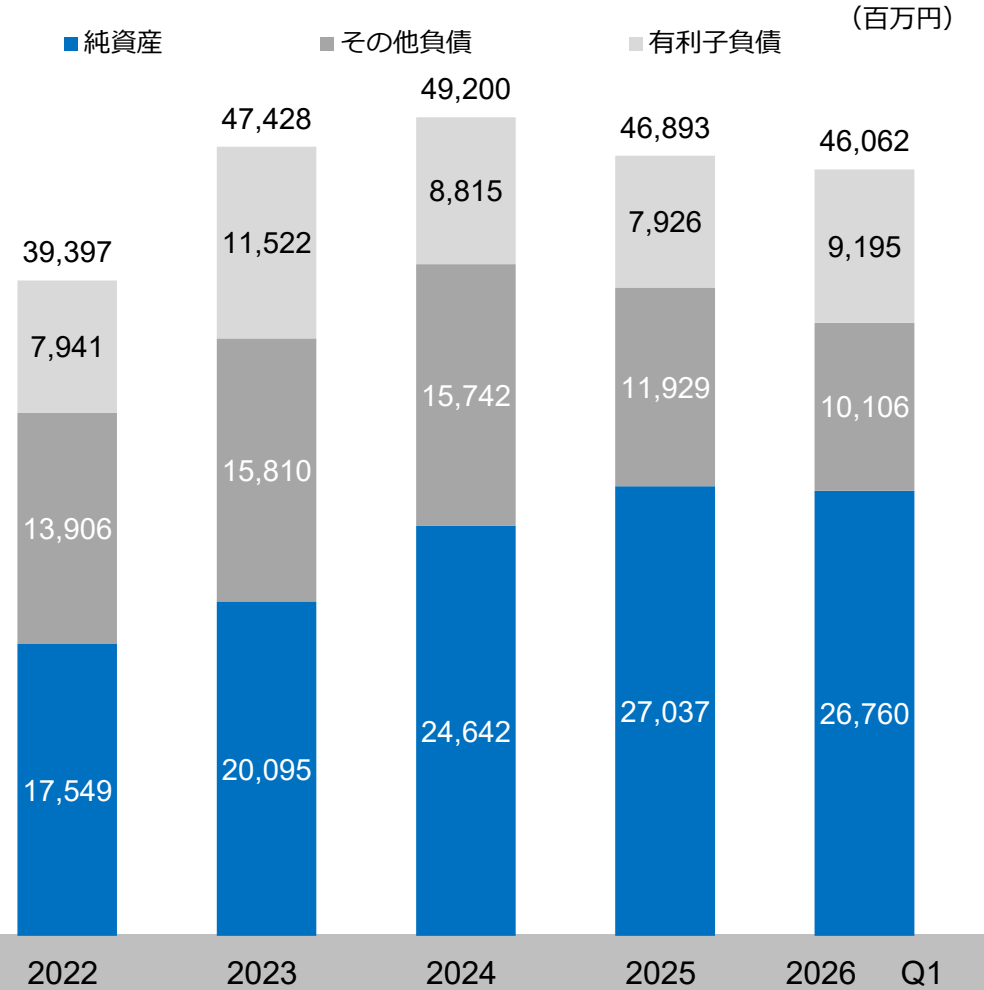
### 固定負債

長期借入金	+828
-------	------

## 資産



## 負債／純資産





# 2

## セグメント別業績

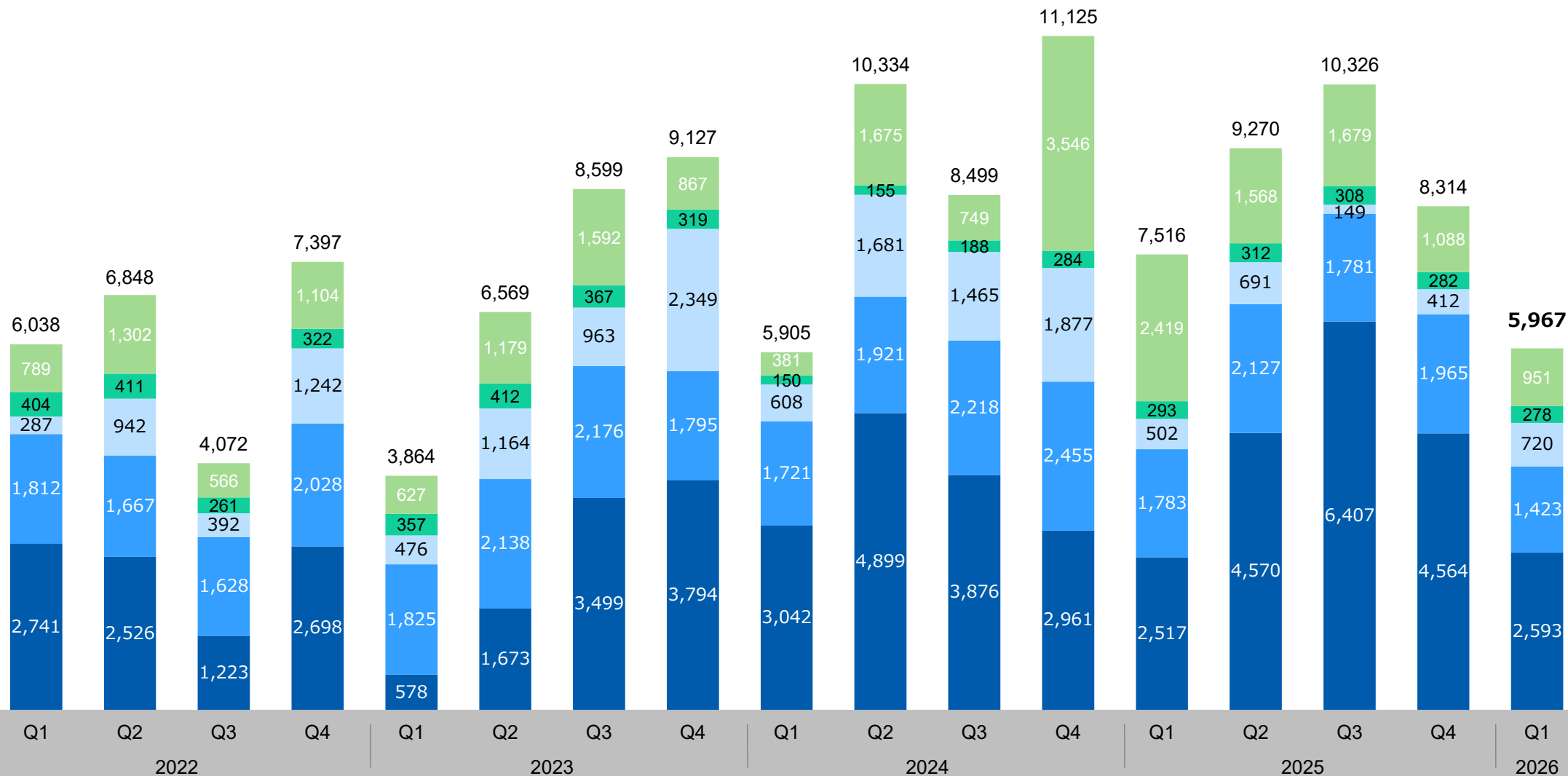
		2025年12月期 Q1 実績	2026年12月期 Q1 実績	前期比 増減率(%)	2026年12月期 計画	進捗率(%)
(百万円)						
<b>プロセス機器事業</b>	売上高	4,803	4,737	△1.4	29,700	15.9
	営業利益	752	60	△92.0	3,400	1.8
■ 半導体装置	売上高	2,517	2,593	3.0	18,500	14.0
■ 搬送機器	売上高	1,783	1423	△20.2	8,860	16.1
■ 洗浄機	売上高	502	720	43.4	2,340	30.8
<b>金型・樹脂成形事業</b>	売上高	293	278	△5.2	1,300	21.4
	営業利益	38	△0	—	70	—
<b>表面処理用機器事業</b>	売上高	2,419	951	△60.7	4,500	21.1
	営業利益	394	14	△96.3	130	10.8
セグメント間連結調整	営業利益	△95	12	—	—	—
<b>合計</b>	売上高	7,516	5,967	△20.6	35,500	16.8
	営業利益	1,210	86	△92.9	3,600	2.4

※2026年12月期より、従来「コーター」セグメントに計上していた事業を「半導体装置」セグメントとの合算表記に変更したため、前期実績についても同様のセグメント区分で記載。

# セグメント別 売上高推移

■ 半導体装置 ■ 搬送機器 ■ 洗浄機 ■ 金型・樹脂成形 ■ 表面処理用機器

(百万円)

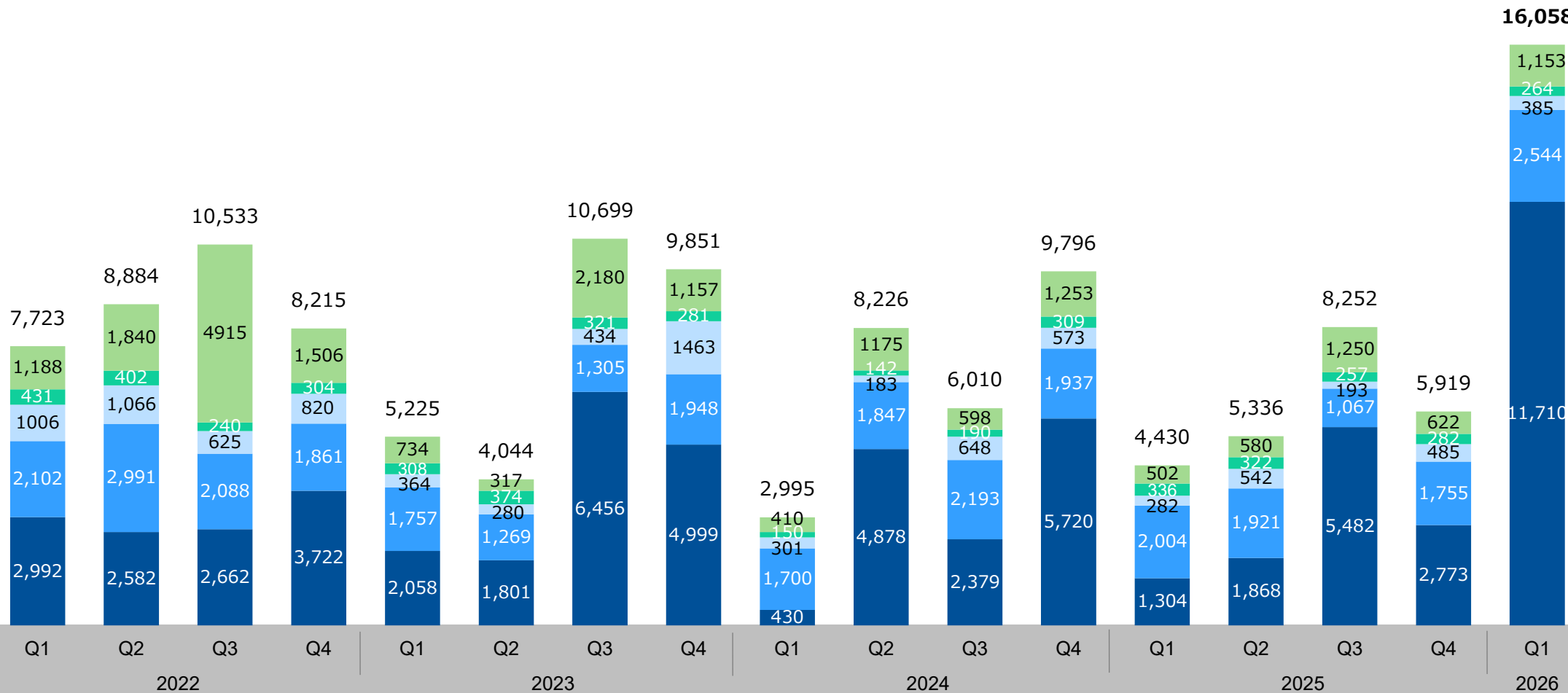


※2026年12月期より、従来「コーター」セグメントに計上していた事業を「半導体装置」セグメントとの合算表記に変更したため、過去実績についても同様のセグメント区分で記載。従来表記の売上高推移は補足資料参照。

# セグメント別 受注高推移

■ 半導体装置 ■ 搬送機器 ■ 洗浄機 ■ 金型・樹脂成形 ■ 表面処理用機器

(百万円)

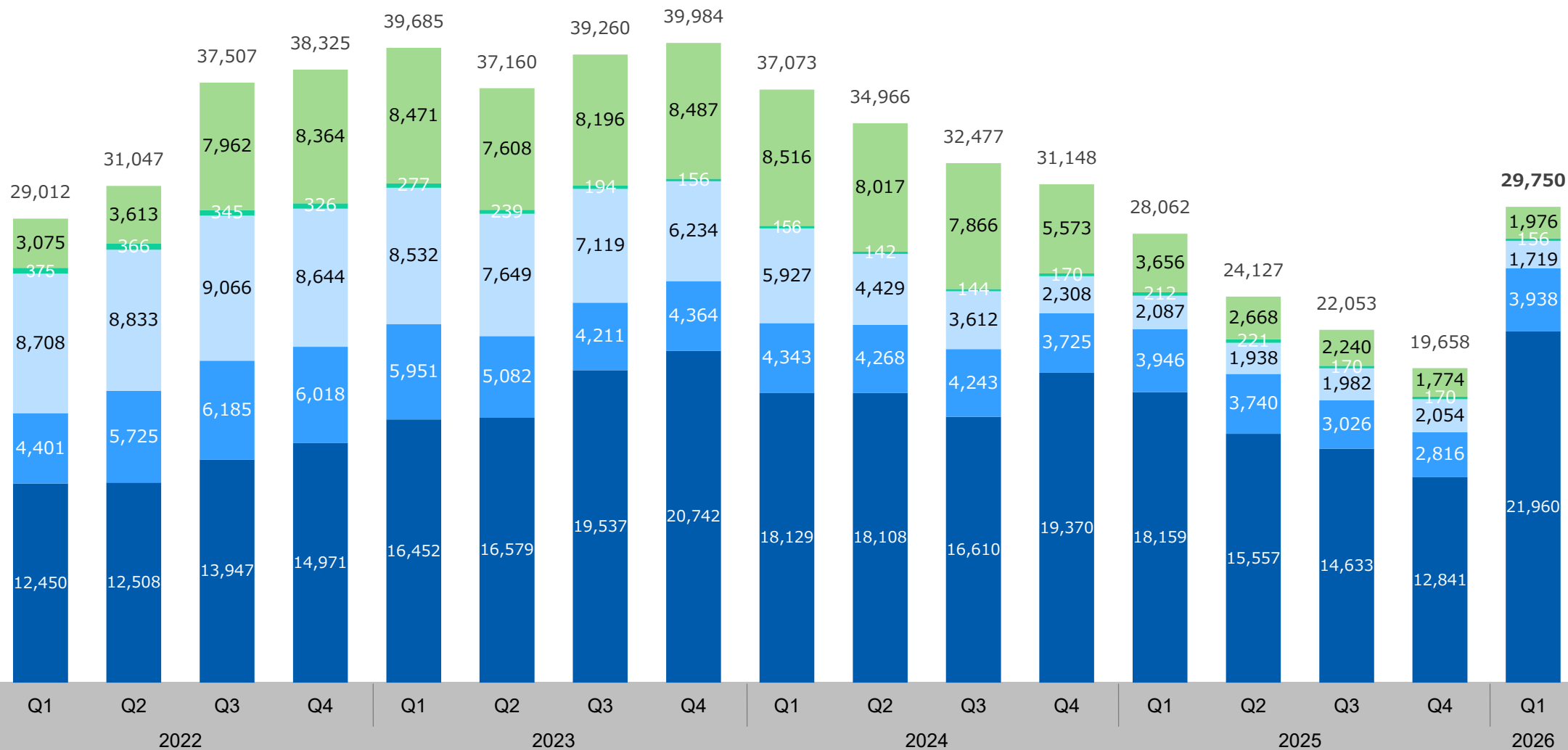


※2026年12月期より、従来「コーター」セグメントに計上していた事業を「半導体装置」セグメントとの合算表記に変更したため、過去実績についても同様のセグメント区分で記載。従来表記の受注高推移は補足資料参照。

# セグメント別 受注残高推移

■ 半導体装置 ■ 搬送機器 ■ 洗浄機 ■ 金型・樹脂成形 ■ 表面処理用機器

(百万円)



※2026年12月期より、従来「コーター」セグメントに計上していた事業を「半導体装置」セグメントとの合算表記に変更したため、過去実績についても同様のセグメント区分で記載。従来表記の受注残高推移は補足資料参照。



3

## 市場（顧客）の状況

- 先端パッケージ向け装置では、大きく受注を伸ばすことができている。今後の投資については市況に大きく左右される部分もあるが、引続き期待している。パワー半導体向け装置では、引合いは増加傾向あり、受注につなげていきたい。
- 先端パッケージ向けPLP装置では、塗布、剥離・洗浄など、これまで取り組んできたプロセスに対する引き合いが増加している。大小様々な引き合いであるが、確実に受注できるよう対応しており、更なる市場の拡大を期待している。
- 搬送機器では、設備投資の回復から引合いが急増しており、PLP装置向けも増加傾向にある。短納期の案件も多く、部品のリードタイムの長期化もあり生産工程の調整が難しくなっている。
- 洗浄装置では、新規案件の話も少なく回復には時間がかかりそう。スラリー供給装置の引合いは増加しているが、ユーザーの投資判断にもう少し時間がかかりそうな状況となっている。
- 表面処理用機器では、基板搬送を中心に受注・引合い状況が回復してきている。今後の投資案件における受注に期待していきたい。

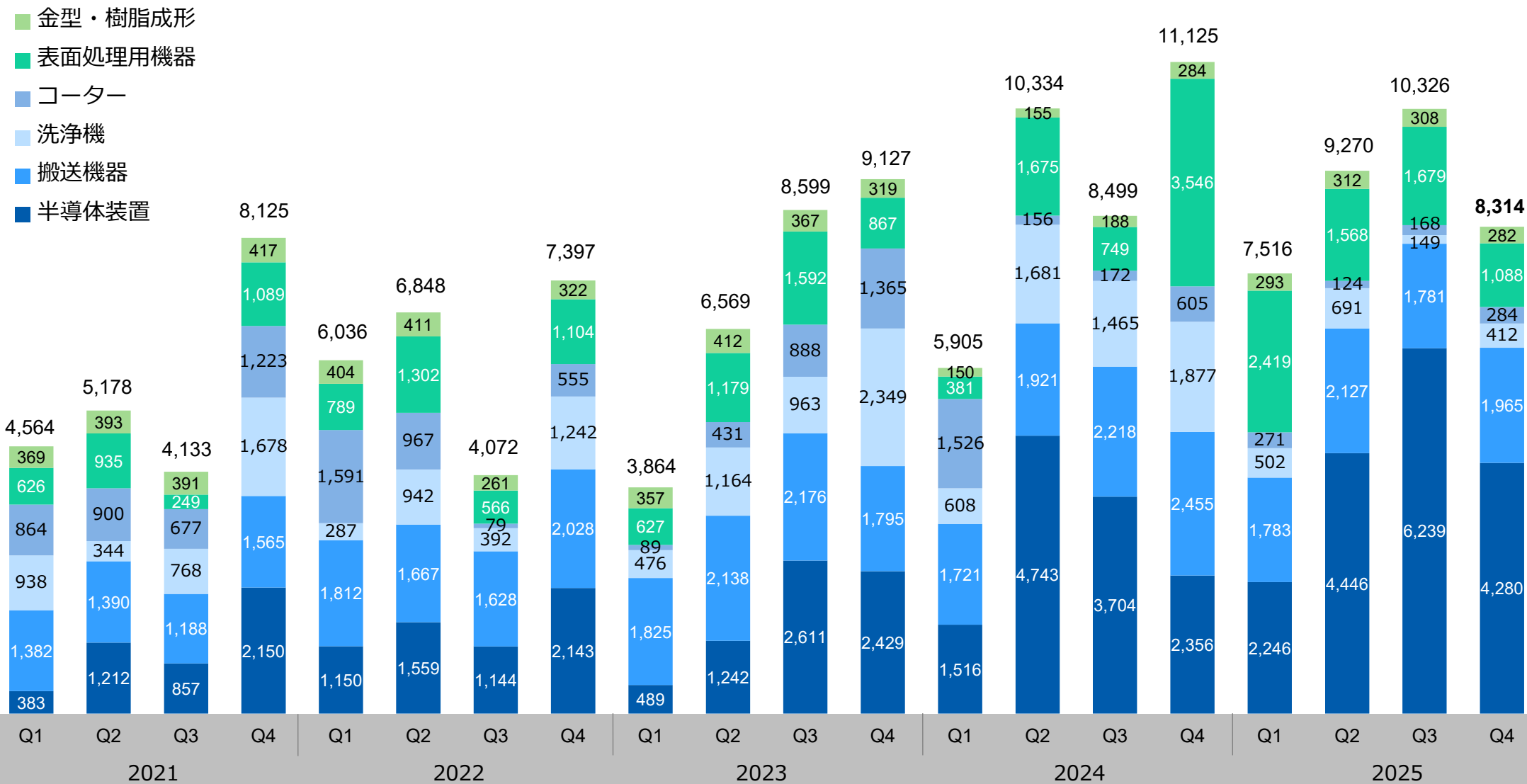


# 4

## 補足資料

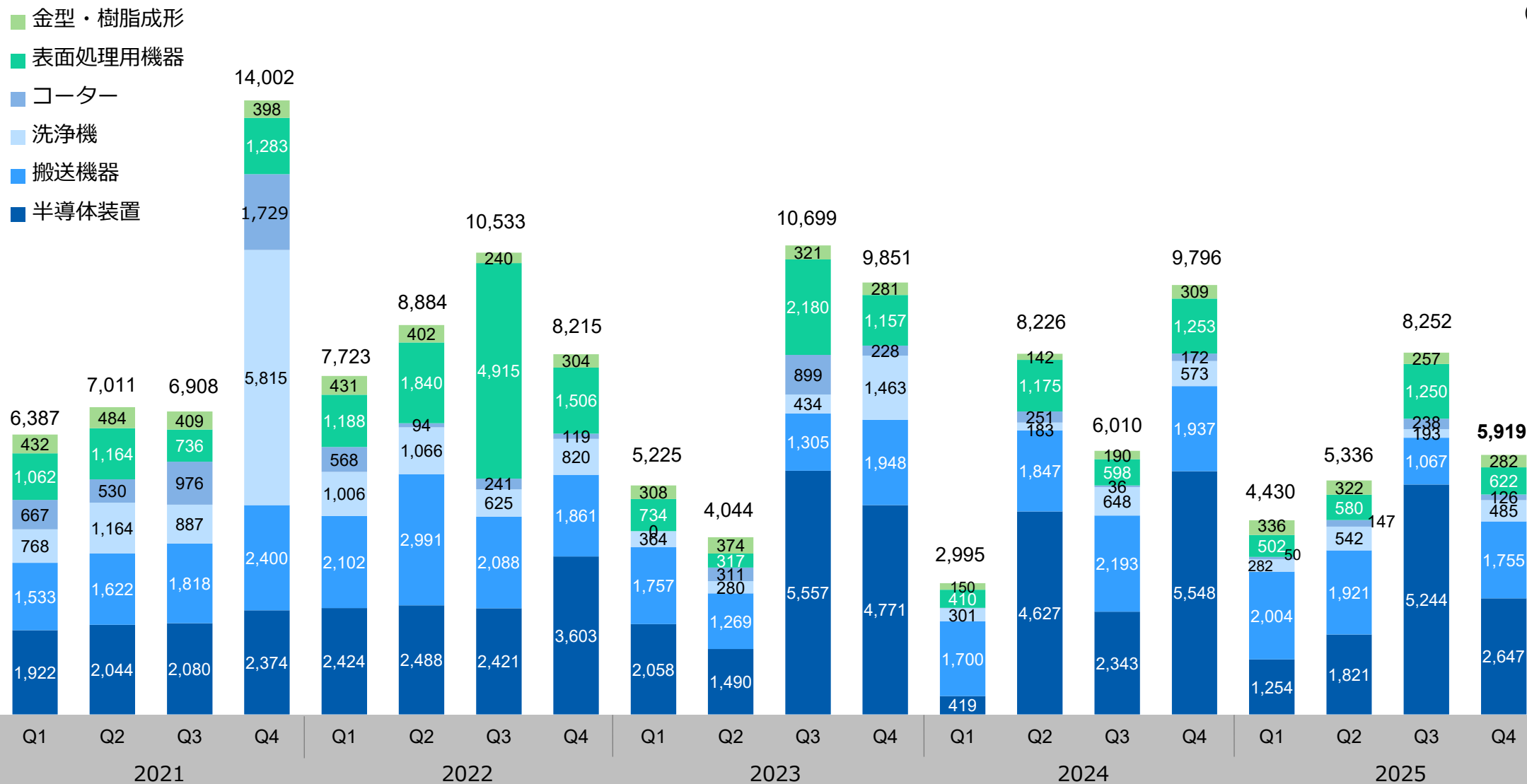
# 従来セグメント別 売上高推移 (四半期)

(百万円)

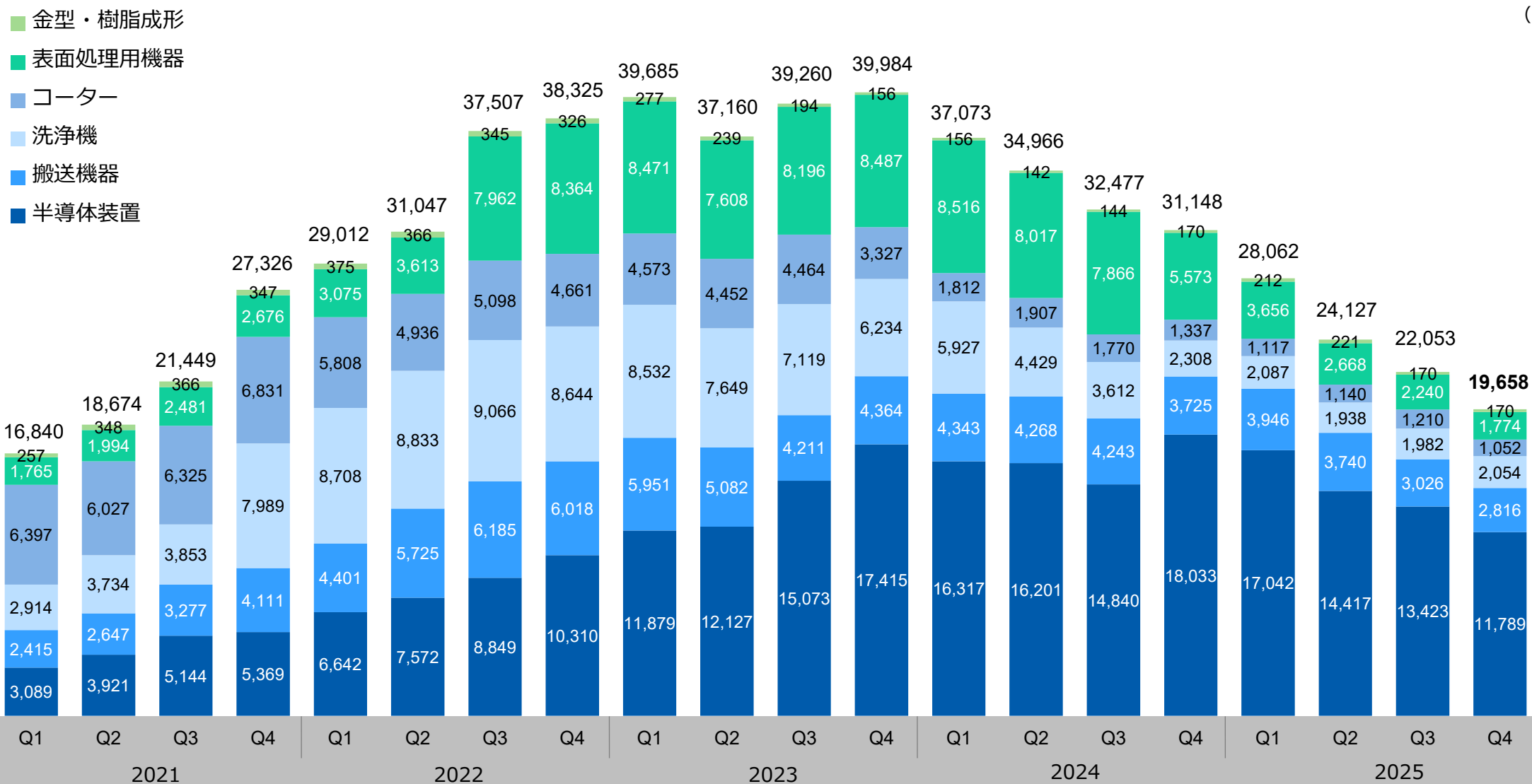


# 従来セグメント別 受注高推移 (四半期)

(百万円)

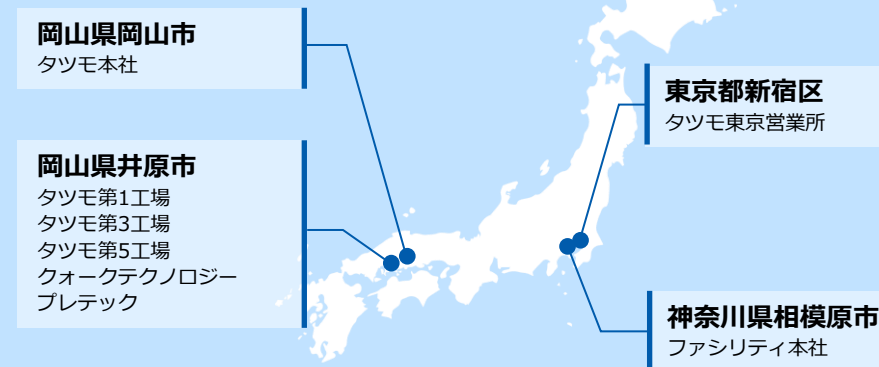


# 従来セグメント別 受注残高推移

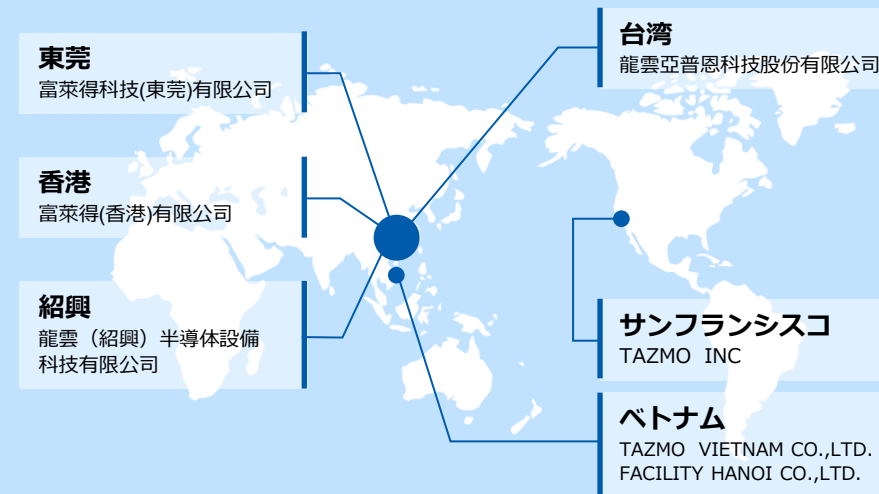


商号	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	35億5,689万682円
発行済株式数	14,842,354株
株主数	9,433名（2025年12月31日現在）
従業員数	単体 449名／連結 1,150名（2025年12月31日現在）
事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、 紫外線照射装置、めっき処理装置、 精密金型・樹脂成形品などの開発・製造・販売

## ■ 主要な国内拠点・関連子会社



## ■ 主要な海外拠点



- 1972 ● - 電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立
- 1980 ● - インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始  
- 半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始
- 1989 ● - 液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
- 1990 ● - 本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転  
- スーパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始
- 1994 ● - エンボスキャリアテープの製造・販売を開始
- 1995 ● - インジェクション成形品の製造・販売を開始
- 2001 ● - 半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、  
- 製造・販売を開始
- 2004 ● - JASDAQ市場に株式を上場
- 2008 ● - TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立
- 2009 ● - 第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始  
- 3M社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結
- 2013 ● - アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化  
- ロンアン省ロンハウ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築
- 2017 ● - 株式会社ファシリティ、株式会社クオークテクノロジーを子会社化
- 2018 ● - 東京証券取引所市場第一部へ市場変更
- 2019 ● - 本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転
- 2020 ● - アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併
- 2022 ● - 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行  
- 公募増資により、資本金34億9,540万円へ増資  
- 中国における半導体関連機器の製造・販売拠点として龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司を浙江省紹興市に設立

## 半導体製造装置事業

### 貼合剥離装置

- 先端パッケージ向け装置（WLP ※1/PLP ※2）
- パワー半導体向け装置



高性能チップの製造に欠かせないウェーハの薄化を実現する仮接合・剥離装置の開発・設計・製造・販売を行っています。ウェーハにガラス支持体を貼り合わせることで、ウェーハの損傷を防ぎながら薄化が可能です。

### 厚膜塗布・現像装置

FPD製造装置の開発・製造で培った知見をもとに、均一な薬液の塗布の実現と、現像装置で露光された部分のみを洗い流すことで精密な回路作りを可能にしています。

※1 WLP : ウェーハレベルパッケージ  
※2 PLP : パネルレベルパッケージ

## 搬送機器事業

- 半導体装置メーカー向け（ウェーハ、マスクなどに対応）



半導体製造装置内で使用される搬送ロボットや、ユニットをフレームに組み込んだEFEMなどの開発・設計・製造・販売を行っています。

## 洗浄装置事業

ウェーハメーカー向けの枚葉洗浄装置のほか、スラリー供給装置、廃液からリン酸を再生・再利用する装置の開発・設計・製造・販売を行っています。

## 金型・樹脂成型事業

コネクタメーカー向けに精密金型や樹脂成形品を提供。

## 表面処理用機器事業

半導体のパッケージや、自動車等の電子制御システムに組み込まれている、プリント回路基板に対するめっき処理装置の提供を行っています。

## 本資料の取扱上の注意

本資料には機密情報が含まれています。  
弊社の書面による承諾無しに複写、又は第三者への開示は出来ません。  
何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

## 本資料に関するお問い合わせ先

**タツモ株式会社 経理部IR課**



**086-239-5000**



**086-239-5100**



**keiki@tazmo.co.jp**